

半導体国際協力に関する主な近況

米国	半導体協力基本原則 (2022年5月4日)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>以下の基本原則に沿って、二国間の半導体サプライチェーンの協力を行う</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. オープンな市場、透明性、自由貿易を基本とし、 2. 日米及び同志国・地域でサプライチェーン強靱性を強化するという目的を共有し、 3. 双方に認め合い、補完し合う形で行う ✓ <u>特に、半導体製造能力の強化、労働力開発促進、透明性向上、半導体不足に対する緊急時対応の協調及び研究開発協力の強化について、二国間で協力していく。</u>
	日米商務・産業パートナーシップ (JUCIP)閣僚会合共同声明 (2023年5月26日)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 「半導体協力基本原則」に基づき設置された日米共同タスクフォースのもと、<u>日米の次世代半導体分野での連携を進め、今後設立が予定される米国のNSTCと、日本のLSTCの間の協力促進を意図することを合意。</u>
EU	半導体に関する協力覚書 (2023年7月4日)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ サプライチェーンの混乱に対処するための<u>早期警戒メカニズム</u>の構築、<u>次世代半導体に関する研究開発、人材育成、最先端半導体のユースケースの創出</u>、及び半導体分野における<u>補助金の透明性確保</u>に向けた取組に関して協力することを合意。
英国	広島アコード 及び 半導体パートナーシップ (2023年5月18日)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>[広島アコード] 半導体パートナーシップの創設とそれに基づく共同研究開発やサプライチェーン強化に向けた連携</u>について明記。 ✓ <u>[半導体パートナーシップ] 経産省と英・科学・イノベーション・技術省の間で、最先端半導体設計、製造、先端パッケージング等互いに強みを有する分野での共同研究開発、官民による日英半導体産業対話、産学官連携強化のための専門家ミッションの派遣、半導体サプライチェーン強靱化に向けた二国間協力等の推進、等の協力を進める。</u>
オランダ	半導体に関する協力覚書 (2023年6月21日)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 経産省と蘭・経済・気候政策省の間で、Rapidus社の研究開発プロジェクトの重要性を共有した上で、<u>半導体・フォトニクス等の関連技術分野における政府・産業界・研究機関による協力の促進</u>や、<u>LSTCとオランダCompetence Centresとの協力促進</u>等に取り組む。
インド	日印半導体サプライチェーン パートナーシップ (2023年7月20日)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 「日印半導体サプライチェーン政策対話」を設置し、(1)相互の強みに基づく<u>半導体供給の強靱性を高めるための取組の検討</u>、(2)<u>人材育成の推進</u>、(3)<u>相互に有益な研究開発協力分野の模索</u>、(4)<u>知的財産保護の推進</u> などに関して合意。